半導體工程系「暑期實習、學期實習、學年實習」申請流程

公告日期：111 年 2 月 25 日

階段	110-2 學期	流程說明
實習前	公告日 至 第 10 週	**實習申請**(班代於期限內收齊資料繳交至系辦，逾時不受理) **需繳交(紙本)資料：** **1.實習申請表(每 1 人 1 張)**：欲實習學生須填寫，並請本系實習輔導老師簽章。 **2.實習機構基本資料與評估表**：同一實習機構填寫一份即可。 收件截止日期：**111/4/29(五)15:00**
	第 11 週	**召開系(所)學生職場實習委員會**
	第 12 週 至 第 14 週	**通過實習機構審查，繳交資料**(班代於期限內收齊資料繳交至系辦，逾時不受理) **需繳交(紙本)資料：** **1.個別實習計畫**：學生需與廠商討論實習內容，將其文字填寫於個別實習計畫，確認無誤後，實習機構輔導之老師與學生本人於『個別實習計畫同意簽署處』簽名，學生再向家長告知實習內容，皆簽名同意後，再找學校實習輔導老師簽名。 **2.職場實習合約書(每 1 人 1 份)**：雙面列印(1 式 3 份)完成實習機構大小章及騎縫章。 **3.保險資料**：以班級為單位，繳交電子檔。 **4.切結書**：學期實習、學年實習者需繳交。 收件截止日期：**111/5/27(五)15:00**
	第 15 週 至 第 17 週	**合約書校方用印、辦理學生保險**
	第 18 週	**實習前說明會(召集學生，建立實習達人網基本資料)**
實習中	實習期間	**實習輔導老師訪視實習學生** **需填報(實習達人網 http://163.18.94.122/Default.aspx)及繳交照片(電子檔)：** **1.訪視紀錄表**：系辦通知實習輔導老師至平台填報。 **2.實地訪視照片**：每次訪視需拍 **3~5 張照片**，請學生或老師回傳至系辦。 ★暑期實習：訪視紀錄至少 2 次，其中實地至少 1 次。 ★學期實習：訪視紀錄至少 2 次，其中實地至少 1 次。 ★學年實習：每學期訪視紀錄至少 2 次，其中實地至少 1 次。 收件截止日期：**111/8/26(五)15:00**
實習後	開學後	**實習結束，繳交成果資料** **需填報(實習達人網 http://163.18.94.122/Default.aspx)及繳交(紙本)資料：** **1.實習生滿意度調查表**：由學生至平台填報。 **2.實習成績考核表(紙本)**：系辦通知實習輔導老師及實習機構填報。 **3.實習機構滿意度調查表(紙本)**：系辦通知實習機構填報。 **4.職場實習課程實習作業(紙本)**：需學生本人簽名及填寫日期。 **實習成果座談會(實習成果未發表者，該項目成績為 0 分)** ★暑期實習：開學後第 1 次系週會發表。 ★學期實習：當學期第 2 次系週會發表。 ★學年實習：每學期第 2 次系週會發表。 收件截止日期：開學第二週前繳交

以上實習資料電子檔放置「系網-表單下載專區」。系辦窗口：劉香伶助理 07-3617141 分機 23352